第一图书网, tushu007.com

<<半导体制造技术>>

图书基本信息

书名：<<半导体制造技术>>

13位ISBN编号：9787121027109

10位ISBN编号：7121027100

出版时间：2006-6

出版时间：电子工业出版社

作者：夸克

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

内容概要

在半导体领域，技术的变化遵循着摩尔定律的快速节奏，是以月而不是以年为单位计的。
本书详细追述了半导体发展的历史并吸收了当今最新技术资料，学术界和工业界都称赞这是一本目前在市场上能得到的最全面、最先进的教材。
全书共分20章，章节根据应用于半导体制造的主要技术分类来安排，内容包括：与半导体制造相关的基础技术信息；总体流程图的工艺模型概况，用流程图将硅片制造的主要领域连接起来；具体讲解每一个主要工艺；集成电路装配和封装的后部工艺概况。
此外，各章为读者提供了关于质量测量和故障排除的问题，这些都是会在硅片制造中遇到的实际问题。
　　本书适合作为高等院校微电子技术专业的教材，也可作为从事半导体制造与研究人员的参考书及公司培训员工的标准教材。

第一图书网, tushu007.com

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com